

# ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОГО УДАЛЕНИЯ ФОТОРЕЗИСТА И ПОЛИМЕРНЫХ СЛОЕВ СО ШЛЮЗОВОЙ ЗАГРУЗКОЙ

## ПЛАЗМА ТМ200-03

**Назначение:** Высокоселективные процессы плазмохимического удаления фоторезистивной маски и травления органических полимеров.



### Особенности:

- Индивидуальная и групповая обработка подложек на подложкодержателе в одном технологическом цикле: 60x48 мм – 7 шт.;  $\varnothing$  76мм – 4 шт.;  $\varnothing$  100, 150, 200мм – 1 шт.;
- Шлюзовая камера для загрузки – выгрузки подложек;
- Транспортная система переноса подложек из шлюзовой камеры в рабочую камеру на основе манипулятора;
- Нагреваемый подложкодержатель до 250°C;
- Рабочие газы: Ar, SF<sub>6</sub>, O<sub>2</sub>, C<sub>4</sub>F<sub>8</sub>, He.;
- СВЧ источник удаленной плазмы для травления радикалами;
- Мощность потребления не более 15,5 кВт;
- Безмасляная система откачки;
- Возможность встраивания в чистую комнату.

